

人工淡水中の電気化学的試験による銅のⅠ型および Ⅱ型孔食再現の試み

メタデータ	言語: jpn
	出版者:日本伸銅協会
	公開日: 2018-02-26
	キーワード (Ja):
	キーワード (En): copper tube, pitting corrosion,
	synthetic freshwater, immersion test, potentiostatic
	polarization test, patina
	作成者: 境, 昌宏, 木谷, 光来, 冨田, 慎太郎
	メールアドレス:
	所属:
URL	http://hdl.handle.net/10258/00009555

[論文]

人工淡水中の電気化学的試験による 銅のI型およびII型孔食再現の試み

室蘭工業大学 もの創造系領域 准教授・工学博士 昌 宏* 境 室蘭工業大学大学院 生産システム工学系専攻 大学院生 木 谷 光 来 室蘭工業大学 機械航空創造系学科 学部生 冨 Ш 慎太郎

Attempt to Reproduce of Type I and Type II Pitting Corrosion of Copper Using Electrochemical Experiment in Synthetic Freshwater

College of Design and Manufacturing Technology, Muroran Institute of Technology, Associate Professor, Dr. Eng. Division of Production Systems Engineering, Muroran Institute of Technology, Graduate Student Department of Mechanical, Aerospace and Materials Engineering, Muroran Institute of Technology, Undergraduate Student

Masahiro Sakai Mitsuki Kiya Shintaro Tomita

(Received March 31, 2016; Accepted May 20, 2016)

There have been two main categories of pitting corrosion of copper in freshwater ; type I and type II. The type I pitting corrosion occurs in the freshwater of relatively high concentration of bicarbonate and the type II in the freshwater of relatively high concentration of sulfate. The aim of this study is to develop an electrochemical test method by which one can reproduce the type I and type II pitting corrosion in artificially synthetic solution in relatively short period. For the type I pitting corrosion, the test solution contains 100mg/L HCO_3^- , 10mg/L SO_4^{2-} and 26.6mg/L Cl⁻ and for the type II, the solution contains 10mg/L HCO₃⁻, 50mg/L SO₄²⁻ and 26.6mg/L Cl⁻. In the test solutions, immersion of copper tube was carried out for two days, followed by a potentiostatic polarization for 4 weeks at a potential nobler by 100mV than the corrosion potential. The above procedure was found to relatively well reproduce the patinas and pits appearing in the real type I and type II pitting corrosion.

Keywords: copper tube, pitting corrosion, synthetic freshwater, immersion test, potentiostatic polarization test, patina

1. 緒言

銅管は熱伝導性、加工性、耐食性に優れることから、 給水・給湯配管、冷媒配管、空調用配管などに現在でも 広く用いられている. 耐食性に優れる銅管であるが、使 用環境によっては孔食が生じる.一説によると、日本、 アメリカ、ドイツいずれの国においても、銅管の腐食事 例で最も多い原因が孔食と言われる¹⁾.銅の孔食は、発生 する水質および孔食を覆う緑青の成分から、これまでI 型、Ⅱ型孔食と分類されており、我が国ではこれにマウ ンドレス型孔食と呼ばれる分類が加わる²⁾. Ⅰ型、Ⅱ型孔 食が発生する水質を区分する指標として、Mattssonが提 案した[HCO3⁻]/[SO4²⁻]、いわゆるマットソン比が従来から

よく知られている3). この比が1より大きい、すなわち重 炭酸イオン濃度が硫酸イオン濃度よりも高い場合には I 型、逆に1より小さい、すなわち硫酸イオン濃度が重炭酸 イオン濃度よりも高い場合にはⅡ型孔食が発生する可能 性がある水質と診断される. 重炭酸イオンが多い水で発 生するI型孔食の場合は、孔食上部に塩基性炭酸銅 CuCO₃·Cu(OH)₂ (Malachite) を主成分とする緑青のマウン ドが、硫酸イオンが多い水で発生するⅡ型孔食の場合は、 塩基性硫酸銅CuSO4·3Cu(OH)2 (Brochantite) を主成分と する緑青のマウンドが形成されると言われる. これら I 型、Ⅱ型孔食の発生・進展メカニズムについてはこれま でにも数多くの研究があるが^{4)~9)}、発生する水質や条件 など、まだ多くの解明すべき点が残されている. メカニ ズム解明のために、実験室にて銅のⅠ型、Ⅱ型孔食を再 現する手法を確立することが重要と考える.

^{*〒050-8585} 室蘭市水元町27-1 Tel: 0143 - 46 - 5377 Fax: 0143 - 46 - 5377

E - mail : msakai@mmm.muroran-it.ac.jp

銅と銅合金 第55巻1号 (2016)

著者らは前報¹⁰において、銅のI型、Ⅱ型孔食を実験 室にて加速再現するために、人工淡水中での定電位保持 試験を実施した.前報では、I型孔食再現水として、塩 化物イオン5mg/L、硫酸イオン10mg/L、重炭酸イオン 100mg/Lを含む水を、Ⅱ型孔食再現水として、塩化物イ オン5mg/L、硫酸イオン50mg/L、重炭酸イオン10mg/L を含む水を用いた.これら人工淡水中で銅管の定電位保 持試験を実施した結果、I型、Ⅱ型孔食再現水ともに、 実際のI型、Ⅱ型孔食で見られる塩基性炭酸銅、塩基性 硫酸銅の緑青が発生したものの、実際の配管で見られる ような孔食形態を再現するまでには至らなかった.本研 究では、引き続き、I型、Ⅱ型孔食を実験室にて比較的 短期間で再現する手法の開発を目指し、I型、Ⅱ型孔食 再現水の水質、電位の印加方法などについて検討した.

2. 実験方法

供試材として長さ100mmのJIS H3300 C1220リン脱酸 銅継目無硬質管(Φ15.88mm×t0.7mm、Cu≥99.90、P:0.015 ~0.040%)を長手方向に1/4割にしたものを用いた.上記 銅管を試験面4.5cm²と端子接続部を残してシリコーン樹 脂で被覆し、実験に供する直前に試験面をアセトン脱脂 した.

2.2 試験水

2.1 供試材

前報¹⁰⁾と同じく、I型孔食再現水の重炭酸、硫酸イオ ン濃度はそれぞれ100、10mg/L、II型孔食再現水の重炭酸、 硫酸イオン濃度はそれぞれ10、50mg/Lとした. これによ り、Ⅰ型、Ⅱ型孔食再現水のマットソン比はそれぞれ10、0.2 となり、Ⅰ型、Ⅱ型孔食が発生するといわれる水質の条 件を満たすことになる. 試験水を作製する際、硫酸イオ ンは硫酸カルシウム二水和物(CaSO4・2H2O)、重炭酸イオ ンHCO3⁻は炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)により添加した. 前報では、Ⅰ型、Ⅱ型孔食ともに上記試験水に塩化物イ オン5mg/Lを塩化ナトリウム(NaCl)にて添加した. このよ うにして作成したⅠ型、Ⅱ型孔食再現水のpHはそれぞれ 8.3、7.6となり、ややアルカリ性となった. 実際に銅の孔 食が発生する水は中性から弱酸性である場合が多いこと から、今回は塩化物イオンの添加に塩酸(HCI)とNaClとを 併用した. 溶液のpHが6.5付近になるように、また、 I 型 孔食再現水とⅡ型孔食再現水の塩化物イオン濃度が等し くなるように、HClとNaClの添加量を調整した. このよう にして調整した試験水中の塩化物イオン濃度は26.6mg/L となった.今回作製した I型、Ⅱ型孔食再現水の水質を Table 1に示す.

2.3 定電位保持試験方法

試験水1Lをガラス製電解槽に入れ、供試材を作用極、 飽和KCl中Ag/AgClダブルジャンクション電極を参照電 極、白金線を対極として、ポテンシオスタット(北斗電工 (株)製、HA-151B)に接続し、作用極に一定電位を印加した. 電位を印加する前に自然浸漬試験を行った.自然浸漬時に エレクトロメーターで作用極の自然電位(Ecorr)を測定し、

Journal of Japan Institute of Copper Vol.55 No.1 (2016)

データロガーにて5分間隔で記録した.今回の試験では以下の2条件で自然浸漬および定電位保持試験を行った.

<u>試験1</u>. 自然浸漬試験を3日間(72時間)実施後、自然電位 より150mV貴な電位(E_{corr}+150mV)に1週間保持 <u>試験2</u>. 自然浸漬試験を2日間(48時間)実施後、自然電位 より100mV貴な電位(E_{corr}+100mV)に4週間保持

定電位保持試験時に流れる電流値はデータロガーにて5分 おきに採取した.試験は液静止、大気開放、室温下(23℃) で行った.試験終了後、試料を試験水から引き上げ自然 乾燥した後、実体顕微鏡にて表面観察を行った.表面に ある程度の量の緑青が生成していた場合には、緑青の一 部を顕微ピンセットにより採取し、FT-IR分析装置(日本 分光(株)製、FT/IR-4100)を用いてFT-IR分析を実施した. その後、試料を希硫酸中で超音波洗浄し、表面の腐食生 成物を除去した後に再び実体顕微鏡による観察を行い、 孔食発生状況を調べた.

3. 実験結果および考察

3.1 自然浸漬試験

Fig. 1に自然浸漬試験時の自然電位の経時変化を示す. 試験1の場合、I型孔食再現水中での自然電位は43mVから67mVへ漸増する挙動を示した. II型孔食再現水中での 自然電位は試験開始時に約30mVを示し、その後20~ 60mVの間を上下変動し、72時間後には約50mVを示した. 試験2の場合、I型孔食再現水中での自然電位は約60mV の一定値を推移した. II型孔食再現水中での自然電位は、 試験開始直後から減少し、10時間後には約-20mVとなっ た. その後10~30時間は約0mV、30時間過ぎから増加し、 40時間後に約60mVに達した後、48時間後には約20mVと なった. 試験1、2ともに、I型孔食再現水中での自然電 位が比較的安定して推移するのに対し、II型孔食再現水 中での自然電位は不安定に上下変動しながら推移する挙 動を示した.

Fig. 2に自然浸漬試験終了後の試料表面を示す. 試験1

Table 1 Chemical composition of test solutions for electrochemical measurement in simulated freshwaters to reproduce type I and type II pits.

		type I	type II
pH		6.5	6.7
electrical conductivity	mS/m	19.6	25.6
HCO3-	mg/L	100	10
SO42-	mg/L	10	50
Cl-	mg/L	26.6	26.6

銅と銅合金 第55巻1号 (2016)

の場合、Ⅰ型、Ⅱ型いずれも試料表面には茶褐色の酸化 皮膜が形成されていることが分かる.ただし、Ⅰ型の方



Fig. 1 Natural immersion potentials of the specimens in the simulated type I and type II freshwaters shown in Table 1 : (a) experiment 1 and (b) experiment 2.

Experiment 1		Experiment 2	
Type I	Type II	Type I	Type II

Fig. 2 Specimen surface after immersion test for 72 hours in experiment 1 and 48 hours in experiment 2.

Journal of Japan Institute of Copper Vol.55 No.1 (2016)

は比較的一様に酸化皮膜が形成されているのに対し、Ⅱ 型の方は試験面の一部に酸化皮膜が形成され、初期の金 属光沢が試験面積の約半分程度残っている点が異なる. 試験2の場合、I型の方は試験面のほぼ全面が初期の金属 光沢を有しているのに対し、Ⅱ型の方は試験1のときと同 様に試験面の一部に島状に茶褐色の皮膜が形成されてい ることが確認された.銅を自然浸漬した際に数日間で形 成されるこの茶褐色の有色皮膜を著者らは「初期皮膜」と 呼び、この皮膜が亜酸化銅Cu2Oからなることを既報¹¹⁾に て明らかにしている.今回の試験水の場合、I型孔食再 現水ではこの初期皮膜が形成されにくく、Ⅱ型孔食再現 水では初期皮膜は試験面の一部に島状に形成されること が分かった. Fig. 1に示した自然電位の値は、試験面の表 面状態の変化に応じて変動するものと思われる. 銅を水 に浸漬した際の試験面の表面状態は、銅の溶解反応と初 期皮膜形成反応とが相互に作用しながら複雑に変化する ことが予測される.よって、今回の試験の場合、Fig.2に 示すように、比較的一様な皮膜が形成された I 型孔食再 現水中では自然電位の変動が少なく、一方、局所的に皮 膜が形成されたⅡ型孔食再現水中では自然電位の変動が 大きくなったものと思われる.

3.2 定電位保持試験結果

Fig. 3に試験1、2の条件下で実施した定電位保持試験時 の電流密度値の経時変化を示す. 試験1の場合 (Fig. 3(a))、 電位印加直後にⅠ型、Ⅱ型いずれも約40µA/cm²の電流が



Fig. 3 Current density-time curves of specimens in potentiostatic polarization tests at (a) E_{corr} +150mV for 1 week in experiment 1 and (b) E_{corr} +100mV for 4 weeks in experiment 2.

流れた. その後は10~40µA/cm²の間を変動しながら推 移した. I型、Ⅱ型孔食再現水で電流密度値の挙動に大 きな違いは見られなかった.これに対し、試験2の場合 (Fig. 3(b))、Ⅰ型、Ⅱ型孔食再現水で電流密度値の挙動 に大きな違いが見られた. I型孔食再現水の場合は、電 位印加直後に約20µA/cm²の電流が流れ、その後は約1日 の周期変動を有しながら徐々に減少する傾向を示した. 特に10日以降は周期性もほとんど見られずに減少し、28 日後の最終的な電流値はほぼゼロとなった.一方、Ⅱ型 孔食再現水中の電流密度値は、試験期間中、漸増する傾 向を示し、電位印加1日後に約5µA/cm²であった電流密 度値が28日後には約10µA/cm²まで上昇した.なお、I型、 Ⅱ型いずれの場合も、約1日の周期性を有して電流密度値 が上下変動しているが、これは試料表面に形成された亜 酸化銅皮膜の性質によるものと思われる. 亜酸化銅は光 と反応する半導体の性質を有するため¹²⁾¹³⁾、試験環境周 囲の光量に応じて電流密度値が1日の周期性を持って上下 変動したものと推察する.

Fig. 4に試験1、2の条件下で定電位保持試験を実施した 後の試料表面を示す. 試験1の場合、I型孔食再現水では、 試験面全体に青白色の緑青が発生し、皮膜の一部が剥落 して下地の銅が露出している箇所も観察された. 一方、 Ⅱ型孔食再現水では、試料全体が黄土色皮膜で覆われ、 その上に青緑色の緑青の存在も確認された. 試験2の場合、 I型孔食再現水中に保持した試料は表面全体が茶褐色に 変色し、局所的に青白色の緑青のマウンドが点在してい た. Ⅱ型孔食再現水中に保持した試料表面も、表面全体 が茶褐色に変色し、青緑色の緑青が島状に分布して発生 した. Fig. 2と比較すると、この緑青が発生した箇所は、 自然浸漬で初期皮膜が形成されずに金属光沢が残ってい た箇所とほぼ一致することが分かる. このことから、先 ず自然浸漬により初期皮膜を形成させ、その後定電位保

Experiment 1		Experiment 2	
Type I	Type II	Type I	Type II

Fig. 4 Specimen surface after potentiostatic polarization test at $E_{\rm corr}{+}150mV$ for 1 week in experiment 1 and at $E_{\rm corr}{+}100mV$ for 4 weeks in experiment 2.

持試験を行えば、初期皮膜以外の箇所に、局所的に緑青 を発生させることが可能となることが示唆された. 試験1 では局所的に緑青が生じずに、試験面全体に緑青が生じ る結果となったが、これは自然電位から貴方向へシフト する電位を150mVと試験2の場合の100mVよりも大きくし たためだと思われる. 実配管で生じる銅の孔食は、比較 的均一な酸化皮膜が管表面に形成された中に、局所的に 緑青が発生し、その下部で腐食が進行している場合が多 い. 今回の定電位保持試験は、印加電位を高く試験時間 を短くした試験1と、印加電位を低く試験時間を長くした 試験2の2条件で実施したが、Fig. 4の表面を見る限りでは、 試験2の方が、孔食が生じた実配管表面に類似した表面が 得られているものと判断される.

試験2で生成した緑青を採取し、FT-IR分析を実施した. その結果をFig. 5に示す. I型孔食再現水中で発生した緑 青のスペクトルは、Fig. 5(a)に示す塩基性炭酸銅CuCO₃・ Cu(OH)₂の市販粉末のスペクトルと類似している.また、 Ⅱ型孔食再現水中で発生した緑青のスペクトルは、 Fig. 5(b)に示す塩基性硫酸銅CuSO₄·3Cu(OH)₂の市販粉末 のスペクトルと類似していた.以上より、Table 1に示す I型、Ⅱ型孔食再現水中で、E_{corr}+100mVの電位に4週間 定電位保持することにより発生した緑青はそれぞれ、実 際のI型孔食で見られる塩基性炭酸銅、およびⅡ型孔食 で見られる塩基性硫酸銅を主成分とするものであること が判明した.



Fig. 5 FT-IR spectra of patinas formed on copper tubes after potentiostatic polarization tests at E_{corr}+100mV for 4 weeks in experiment 2 in the simulated (a)type I and (b)type II freshwaters.

Fig. 6に定電位保持試験終了後の銅管試料表面拡大観察 結果を示す. 試験水から引き上げ乾燥後の試料表面にお いて、緑青が発生した箇所を顕微鏡観察した(Fig. 6中、 before wash). また、緑青観察後に試料表面を希硫酸中で 超音波洗浄し、緑青や酸化皮膜を除去した後に、洗浄前 に緑青が発生していた箇所を再び顕微鏡観察した(Fig. 6 中、after wash). 試験1の I 型孔食再現水では、粒子状の 緑青が表面全体に発生しており、局所的にその緑青が密 集して存在している箇所も確認された.ただし、洗浄後 の表面から孔食は確認できなかった. Ⅱ型孔食再現水で は、黄土色皮膜部中心に孔食が発生しているのが洗浄前 表面からも観察できた. この黄土色皮膜の周囲に針状緑 青が発生していた.洗浄後の表面からは半球状の食孔が 観察された. 試験2の方は、Ⅰ型、Ⅱ型孔食再現水ともに、 茶褐色皮膜の上に局所的に緑青のマウンドが存在してい る箇所が観察された. I型孔食再現水中で発生した緑青 は青白色で粒子状、Ⅱ型孔食再現水で発生した緑青は青 緑色で針状であった.洗浄後の表面を観察すると、 I 型 の方は肌荒れ状の浅い腐食が、Ⅱ型の方は緑青が存在し た箇所の中心部が半球状に侵食されている様子が確認で きた. 実際の配管で生じる銅の孔食は試験2で見られるよ うに、管表面全体に酸化皮膜が生じた中に局所的に緑青 が点在し、その下部が食孔となっていることが多い. 今回、 試験2の条件で定電位保持試験を実施することにより、実 際の配管に生じる孔食形態と類似した孔食を再現できる ことが分かった.

		before wash	after wash
ment 1	Tvpe I		
Experi	Tvpe II	3	
Experiment 2	Tvpe I		
	Tvpe II		0 <u>.2mm</u>

4. 結言

銅管に発生するⅠ型、Ⅱ型孔食を人工淡水中での定電 位保持試験により加速的に再現することを試みた. I型、 Ⅱ型孔食再現水のマットソン比はそれぞれ10、0.2とし、 いずれの試験水もpHが6.5付近になるように塩化物イオン と塩酸とで調整した. 定電位保持試験の前にⅠ型、Ⅱ型 孔食再現水中で自然浸漬試験を行った. I型孔食再現水 中での自然電位は比較的安定して推移するが、Ⅱ型孔食 再現水中での自然電位は上下に大きく変動し、自然浸漬 終了後の試料表面は、I型の方は比較的一様に酸化皮膜 が形成されるのに対し、Ⅱ型の方は局所的に酸化皮膜が 形成されることが分かった.自然浸漬試験を2日間実施し、 その後自然電位から100mV貴な電位に4週間保持する定電 位保持試験を実施した. その結果、Ⅰ型、Ⅱ型孔食再現 水いずれの場合も、試験面全体に亜酸化銅と思われる茶 褐色皮膜が形成し、その上に局所的に緑青のマウンドが 確認された.この緑青をFT-IR分析した結果、I型孔食 再現水中で発生した緑青は実際のI型孔食の緑青主成分 である塩基性炭酸銅であり、Ⅱ型の方は実際のⅡ型孔食 の緑青主成分である塩基性硫酸銅であることが分かった. 緑青下部にはⅠ型の方では浅い腐食が、Ⅱ型の方では半 球状の食孔が発生していた.以上より、今回用いた試験 水中で、自然電位から100mV貴な電位に4週間保持するこ とで、実際の配管で発生する銅のⅠ型、Ⅱ型孔食と類似 した孔食を再現できることが判明した.

謝辞

本研究は、日本銅学会平成26年度研究助成金による研 究である.

参考文献

- 防錆・防食技術総覧編集委員会:「防錆・防食技術総 覧」,(株)産業技術サービスセンター (2000), p.747.
- 2) 山田豊:材料と環境, 50 (2001), 88-93.
- E. Mattsson and A.-M. Fredriksson : Br. Corros. J., 3 (1968), 246–257.
- 4) H.S. Champbell : *Journal of the Institute of Metals*, 77 (1950), 345–356.
- R. May : Journal of the Institute of Metals, 82 (1953), 65-74.
- V.F. Lucey : British Corrosion Journal, 2 (1967), 175-185.
- T. Fujii, T. Kodama and H. Baba : Corrosion Science, 24 (1984), 901-912.
- M. Edwards, J.F. Ferguson and S.H. Reiber : Journal of American Water Works Association, 86 (1994), 74-90.
- D.B. Harrison, D.M. Nicholas and G.M. Evans : Journal of American Water Works Association, 96 (2004), 67-76.
- 10) 境 昌宏,田中優樹:銅と銅合金,54 (2015),85-91.
- 11) 境 昌宏,田中優樹:材料と環境,64 (2015),302-306.
- 12) A. Aruchamy and A. Fujishima : J. Electroanal.

Fig. 6 Optical micrographs of patinas and pits formed on specimen surface after potentiostatic polarization tests.

Journal of Japan Institute of Copper Vol.55 No.1 (2016)

Chem., **272** (1989), 125–136.

13) W. Siripala and K. Premasiri Kumara : Semicond.

Sci. Technol., **4** (1989), 465-468.